



2021年12月期第2季度 決算説明資料

株式会社RS Technologies

2021年8月11日



东证1部
3445

目录

公司概况 P. 3

公司概况
历史沿革
DG Technologies新工厂竣工
中国子公司上市准备进度(2021年5月)
现在的RS Technologies
硅片再生事业各地区供货量构成比

2021年12月期第2季度 决算概况 P. 14

决算概况(累计)
各事业及各公司的动向(累计)
营业利益增减要因分析(累计)
算概要(4-6月)
各事业及各公司的动向(4-6月)
各事业动向 季度业绩图
各公司动向 季度业绩图
资产负债表及现金流
特别损失(股份报酬费用)
2021年12月期 决算预期

中期经营计划(21年~23年) P. 25

设备投资计划:硅片再生事业
设备投资计划:PRIME WAFER事业
中国投资计划(时间表)
硅片再生事业的新需求
再生硅片的需求前景
第3成长引擎:DG Technologies成长战略
RS Technologies追求的世界

Appendix1 中国子公司上市准备 P. 35

中国子公司上市准备(2020年9月)
中国子公司上市准备的进展(2020年11月)

Appendix2 P. 38

董事长方永义的优势
硅片再生业务(1)(2)
硅片再生事业的制造据点
进军PRIME WAFER行业
关于我们在中国的合资伙伴
与山东省德州市的合作:背景、经过及现状
PRIME WAFER事业的制造与研究开发据点
对中国事业的出资方案
12寸PRIME WAFER事业
业绩变化·主要财务报表·各事业业绩变化

1. 公司概况

公司概况

- 硅片再生市场份额占30%的全球领先企业* 1。
- 与中国中央政府直属企业合资，全面进军PRIME WAFER业务。
- 通过M&A将业务扩展到可以实现协同效果的相关业务领域。

公司名称	株式会社RS Technologies
成立日期	2010年12月10日
经营理念	“爱护地球环境，赢得世界各地客户的信赖，坚持不懈地创造挑战。”
业务内容	电子材料、电子器械元件、通信器械元件材料的制造、加工、再生、销售，太阳能发电业务。旧半导体设备的收购和销售业务。半导体材料和元件的销售。半导体硅片制造的技术咨询服务。
总部地址	东京都品川区大井1-47-1 NT 大厦12楼
三本木工厂	宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2
资本金	5,438百万日元（截止2021年6月底）
代表取締役	方 永义
主要子公司	艾尔斯半导体股份有限公司（台湾）资本金 NT \$300 million 出资比例100%
	北京有研艾斯半导体科技有限公司（北京）注册资本US \$138 million 出资比例45% ※2
	有研半导体硅材料股份公司（北京）注册资本 10亿人民币 出资比例47.17% ※2
	株式会社Union Electronics 资本金 27百万日元 出资比例100%
	山东有研半导体材料有限公司（山东省德州市）注册资本金15亿人民币 出资比例37.74% ※2
	株式会社DG Technologies 资本金 100百万日元 出资比例100%

* 1 由本公司根据SEMI数据估算。

* 2 在中国业务中，属于合并对象的出资计划包括，将北京有研艾斯半导体科技有限公司作为总公司，将有研半导体材料有限公司作为子公司，山东有研半导体材料硅材料股份公司作为孙子公司，出资部分重复。有关详细信息，请参阅P47“对中国事业的出资方案”。（2021年5月开示内容实施后）

历史沿革

- 硅片再生业务的全球领导者。与中国一家主要PRIME WAFER制造商合资成立子公司，晋升为综合硅片制造商。
- 2020年10月，山东省德州市的山东GRITEK新工厂竣工，开始生产。

2010年12月	以硅片再生业务为主要业务，成立株式会社RS Technologies
2011年1月	在三本木工厂开工
2011年11月	三本木工厂通过UKAS“ISO9001:2008”（质量管理体系）认证审核
2013年10月	在三本木工厂开始太阳能业务
2014年2月	在台湾成立子公司——艾尔斯半导体股份有限公司（现为合并子公司）
2015年3月	在东京证券交易所创业板上市
2015年6月	引进最先进设备（可再生18英寸硅片）的三本木工厂和第8工厂竣工
2015年12月	艾尔斯半导体股份有限公司（现为合并子公司）的台南工厂竣工
2016年9月	变为东京证券交易所主板上市企业
2017年12月	与北京有研科技集团有限公司（GRINM）和福建仓元投资有限公司签订三家公司的合资合同
2018年1月	成立北京有研RS半导体科技有限公司（BGRS），将中国PRIME WAFER制造商有研半导体材料有限公司（GRITEK）变为合并子公司
2018年5月	取得100%的株式会社Union Electronics的股份
2018年8月	设立山东有研半导体材料有限公司（GRITEK合并子公司、山东GRITEK）
2019年1月	取得株式会社DG Technologies（DG）100%股份
2019年12月	与GRINM、德州汇达半导体股权投资基金合作企业及山东省德州市政府之间签订四方合并合同
2020年2月	成立上海悠年半导体有限公司（上海悠年）
2020年3月	成立山东有研RS半导体材料有限公司（SGRS）及有研艾唯特（北京）科技有限公司（北京IVT）
2020年10月	中国的PRIME WAFER生产据点山东GRITEK的新工厂竣工，开始生产。
2021年5月	作为DG第2生产据点，设立了栗原工厂（宫城县栗原市）
2021年6月	随着GRITEK上市的准备变更组织形态并变更公司名称（新公司名：有研半导体硅材料股份公司）



三本木工厂 (RS Technologies、硅片再生事业)

- 2011年1月开始运作。
- 2015年6月，配备最先进设备（可再生18英寸硅片）的三本木工厂和第8工厂竣工。



社名	株式会社RS Technologies
运作	2010年12月
产品	5, 6, 8, 12英寸再生硅片
生产能力	8英寸： 月产13万片 12英寸： 月产26万片
所在地	宫城県大崎市
认证	ISO9001、ISO14001

台南工厂 (RSTW、硅片再生事业)

- 2014年2月，在台湾成立艾爾斯半導體股份有限公司 (RSTW)。
- 2015年12月，台南工厂竣工。



社 名	艾爾斯半導體股份有限公司
竣 工	2015年12月
制 品	12英寸再生硅片
生产能力	12英寸： 月产16万片
所 在 地	台湾台南市
认 证	ISO9001、ISO14001

德州工厂（山东GRITEK、8英寸PRIME WAFER事业）

- 2018年8月、设立山东有研半导体材料有限公司（GRITEK的连结子公司、山东GRITEK）。
- 2020年10月、新工厂完成竣工,作为新的PRIME WAFER制造点开始运作。



社名	山东有研半导体材料有限公司
竣工	2020年10月
製品	5, 6, 8英寸PRIME WAFER
生産能力	5英寸 : 月産5万片 6英寸 : 月産15万片 8英寸 : 月産13万片※
所在地	中国山东省德州市
認証	ISO9001、ISO14001

※2021年末预计达成操业（月产13万片）

国泰工厂 研究开发中心 (SGRS、12英寸PRIME WAFER事业)

- 2020年3月、设立山东有研RS半导体材料有限公司 (SGRS)。
- 2021年设立月产1万片测试线、正在进行质量改进和批量生产的研究和开发。



※照片是中国北京市国泰工厂内的研究开发中心



社名	山东有研RS半导体材料有限公司
竣工	2020年3月
製品	12英寸PRIME WAFER
生産能力	12英寸：月产1万片 (测试线)
所在地	中国山东省德州市※

DG Technologies 新工厂竣工

- 因神栖工厂完全运作，为应对增长的顾客需求，2021年5月设立了宫城县栗原工厂。
- 由以前的生产据点神栖工厂与栗原工厂（新设）2个据点对应增加的订单。

神栖工厂



工厂名

DG Technologies 神栖工厂

所在地

茨城县神栖市

建筑面积

5,378m²

栗原工厂



硅电极



石英环

工厂名

DG Technologies 栗原工厂

所在地

宫城县栗原市

建筑面积

5,000m²

中国子公司 (GRITEK) 上市准备进度 (2021年5月开示時点)

- 作为中国子公司 (GRITEK) 上市准备工作的一部分, 2021年5月19日召开的董事会作出决议, 转让GRITEK 第三方发行的新股及本公司的权益控股公司 (SGRS) 的股份。

概要

- ◇ 向机构投资者和本公司的第三方增资
通过GRITEK向机构投资者和本公司实施第三方增资
- ◇ 转让本公司权益控股公司 (SGRS) 的股份
将 RS 持有的 SGRS 股份转让给 GRITEK (股份交换)

目的

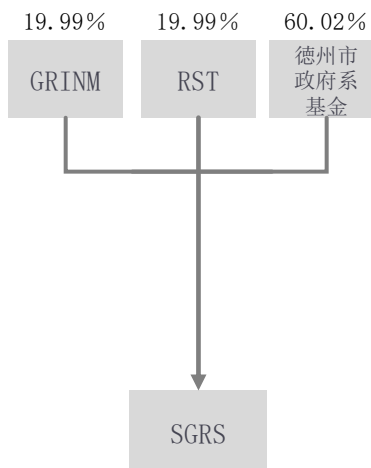
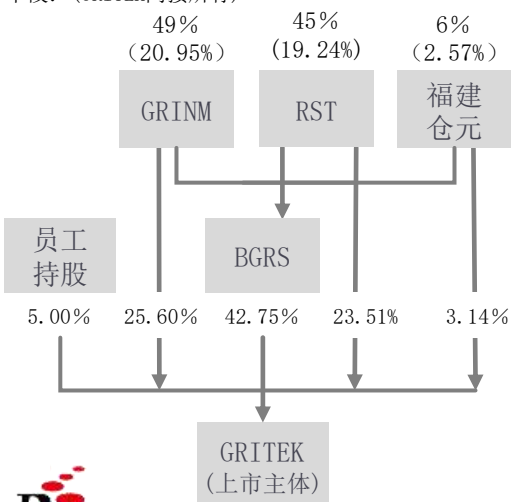
- ◇ 向机构投资者的第三方增资
确保在科创板市场上市后的股东多元化
- ◇ 向本公司的第三方增资
强化本公司对GRITEK的控制
- ◇ 转让本公司权益控股公司 (SGRS) 的股份
整合实施PRIME WAFER战略

本案前

8英寸事业

12英寸事业

上段: BGRS所有
下段: (GRITEK间接所有)

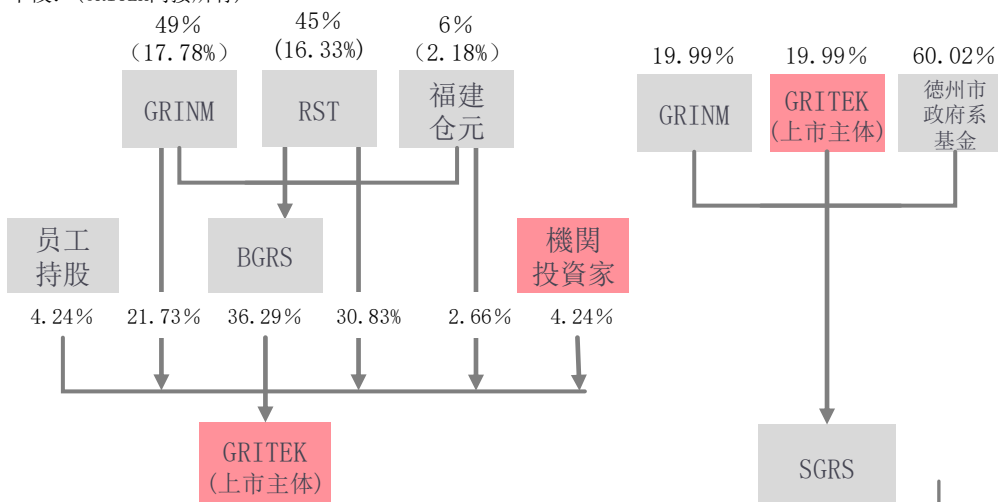


本案后 (截至6月末)

8英寸事业

12英寸事业

上段: BGRS所有
下段: (GRITEK间接所有)

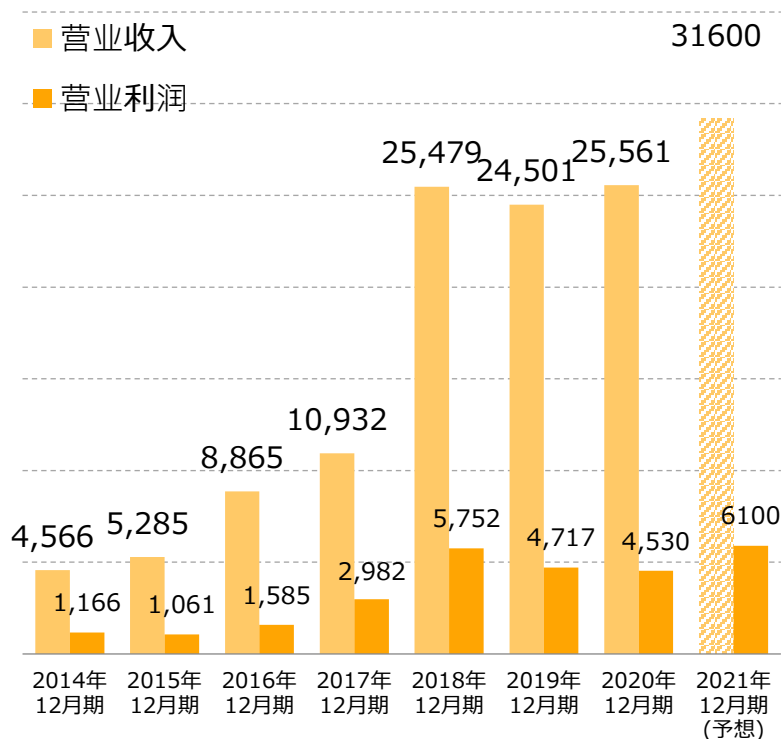


现在的RS Technologies

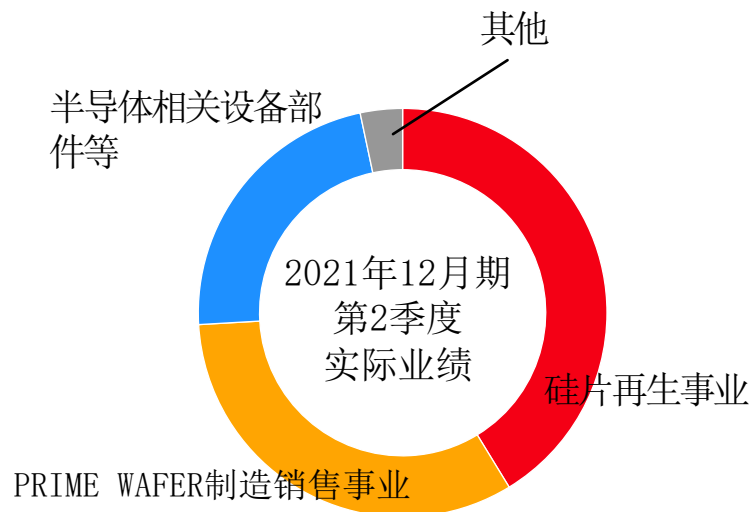
- 硅片再生事业 + PRIME WAFER事业的综合硅片制造商
- 在半导体相关设备部件等事业及太阳能事业领域扩展业务
- 硅片再生事业在全球占领先地位，PRIME WAFER事业主要面向中国，以中国国内为中心开展PRIME WAFER事业。

合并营业收入及利润

(百万日元)

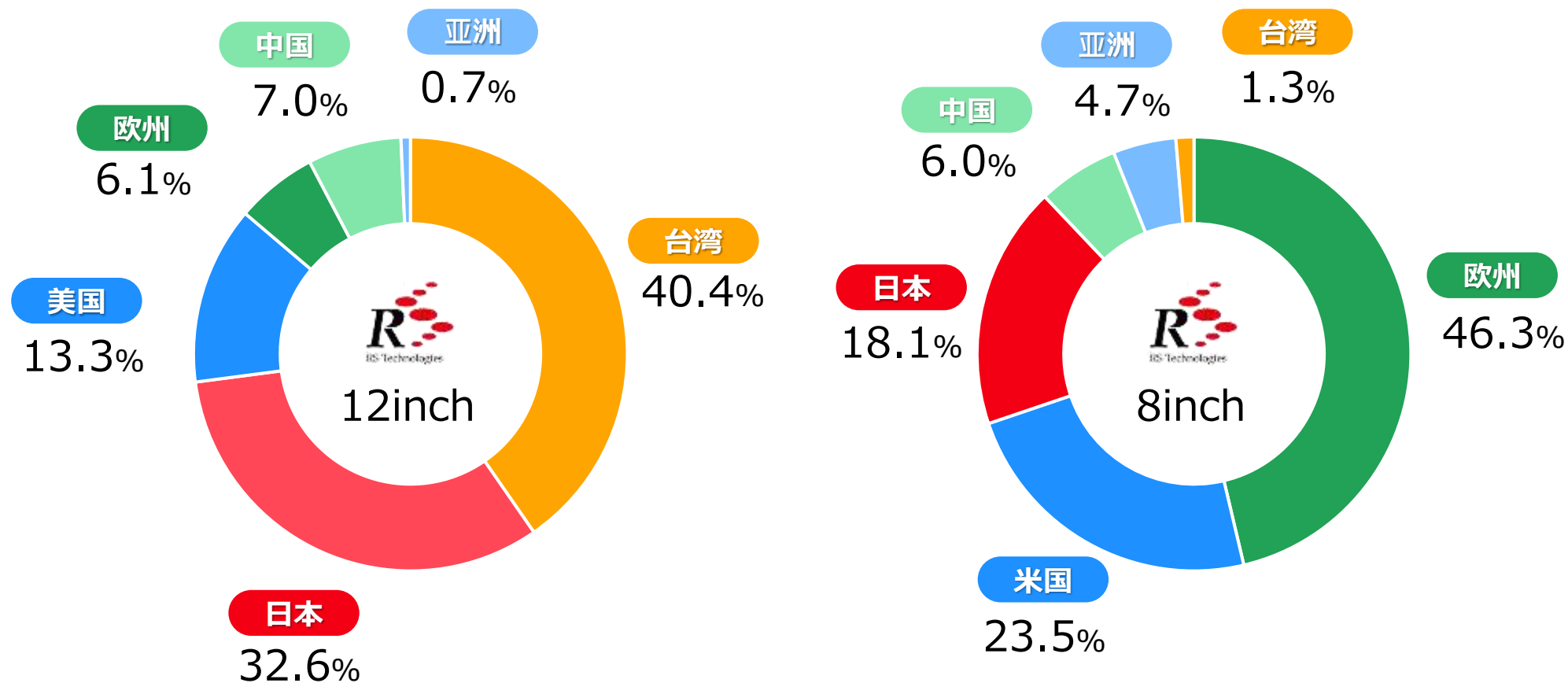


各事业领域营业收入



硅片再生事业各地区供货量构成比

- 客户以日本、台湾、欧美为中心的世界主要半导体制造商。
- 2022年、中国SGRS德州工厂开始生产，日台中の3制造点可应对今后不断增长的供片需求。



2. 2021年12月期第2季度 決算概況

2021年12月期第2季度(累计) 决算概况

- 由于硅片再生业务和半导体相关设备部件的贡献，销售额同比增长。
- Prime Wafer业务的研发费用增加导致营业利润同比下降，但因收到研发的补助金，经常利润比去年同期增长。
- 归属母公司的净利润因为特别损失的影响，同比下降。

(百万円)	2020年12月期 第2季度	2020年12月期 第2季度 计划	2021年12月期 第2季度	前期比	前期比 增减率	原计划比	2021年12月期 修改后的计划	全年进度 (修改后 计划比)
营业收入	12,653	13,100	15,559	+2,906	23.0%	+2,459	31,600	49.2%
营业利润	2,580	2,200	2,464	△116	△4.5%	+264	6,100	40.4%
营业利润率	20.4%	16.8%	15.8%	△4.6pt		△1.0pt	19.3%	
经常利润	2,898	2,200	3,662	+764	26.4%	+1,462	7,300	50.2%
经常利润率	22.9%	16.8%	23.5%	+0.6pt		+6.7pt	23.1%	
归属于母公司 股东本期净利润	1,686	1,300	630	△1,056	△62.6%	△670	3,100	20.3%
每股本期净利润	131.27円	100.86円	48.77円	△82.50円	△62.8%	△52.09円	240.51円	

* 2021年12月期第2季度最初计划为2021年2月12日，2021年12月期修改后计划为2021年8月4日公布的数值。

2021年12月期第2季度 各业务及各公司动向

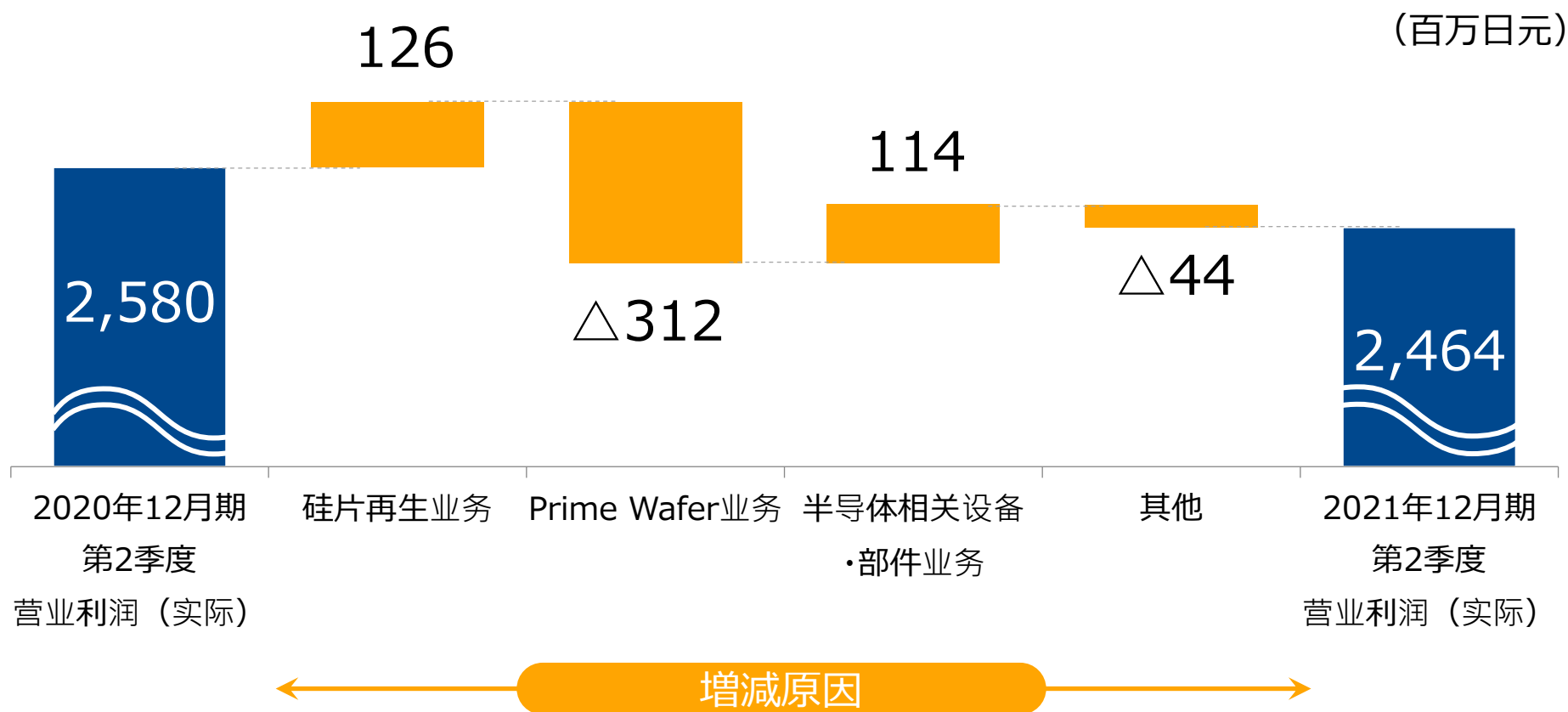
- 硅片再生业务由于强劲的客户需求及设备投资的一部分贡献，销售额和利润同比增长
 - Prime Wafer业务由于新工厂的运营和客户认证的进展，销售额有所增加。研发费用增加导致营业利润下降（※）。
 - 半导体相关设备、部件的业务因强化营业体制而销售增加、销售额和利润同比增长。
- （※）研发费用由于收到政府补助抵销（补助记为营业外收入）

各业务 (百万日元)	硅片再生业务		Prime Wafer业务		半导体相关设备部件 等业务		其他、调整金额		合并总计	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
营业收入	6,132	7.4%	5,980	25.2%	4,229	63.8%	△782	—	15,559	23.0%
营业利润	2,230	7.6%	561	△35.7%	176	87.2%	△503	—	2,464	△4.5%
营业利润率	36.4	0.1pt	9.4	△8.9pt	4.2	0.6pt	—	—	15.8	△4.6pt

各公司 (百万日元)	RS		台湾子公司		中国子公司		其他子公司		合并总计	
		前期比		前期比		前期比	合并抵消	前期比		前期比
营业收入	6,681	27.9%	2,708	14.0%	5,841	22.7%	329	—	15,559	23.0%
营业利润	1,320	34.4%	762	△0.6%	485	△47.3%	△103	—	2,464	△4.5%
营业利润率	19.8	1.0pt	28.2	△4.1pt	8.3	△11.1pt	—	—	15.8	△4.6pt

2021年12月期第2季度（累计）营业利润增减原因分析

- 营业利润同比下降主要是由于研发费用增加导致Prime Wafer业务利润减少。但是，因为收到中国政府的补助金(营业外收入)，研究开发费用相等的金额在经常利润阶段可以抵消。



2021年12月期第2（4-6月）決算概況

- 由于硅片再生业务和半导体相关设备部件的贡献，销售额同比增长。
- 营业利润因为营业收入增加，同比增长。
- 归属母公司的净利润因为销售额增加，同比利润增长。

(百万円)	2020年12月期 第2季度	2021年12月期 第2季度	前期比	差额
营业收入	6,470	8,875	37.2%	+2,405
营业利润	1,407	1,709	21.5%	+302
营业利润率	21.7%	19.3%		△2.4pt
经常利润	1,490	2,471	65.8%	+981
经常利润率	23.0%	27.8%		+4.8pt
归属于母公司股东 本期净利润	860	1,170	36.0%	+310
每股本期净利润	66.83円	90.60円	35.6%	+23.77円

2021年12月期第2季度（4-6月）各业务及各公司动向

- 硅片再生业务由于强劲的客户需求及设备投资的一部分贡献，销售额和利润同比增长。
- Prime Wafer业务由于新工厂的运营和客户认证的进展，销售额有所增加。
- 半导体相关设备、部件的业务因强化营业体制而销售增加、销售额和利润同比增长。

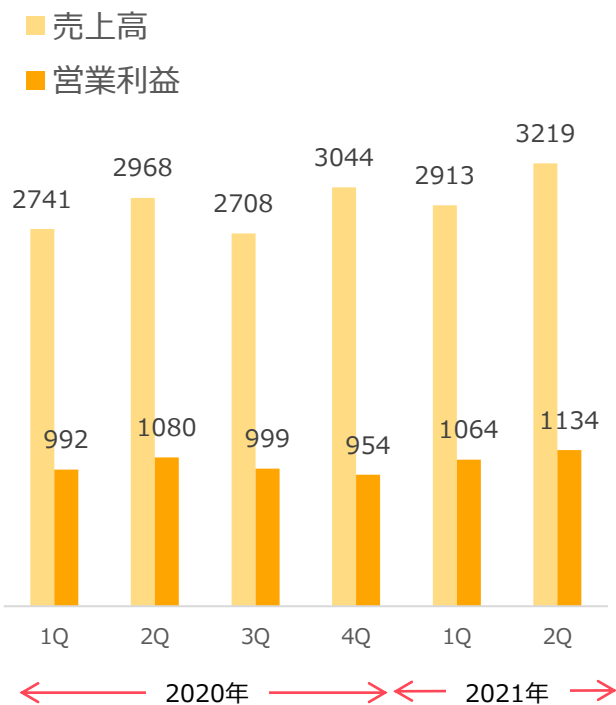
各业务 (百万日元)	硅片再生业务		Prime Wafer业务		半导体相关设备部件 业务		其他、调整金额		合并总计	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
营业收入	3,219	8.5%	3,700	47.0%	2,331	92.3%	△375	-	8,875	37.2%
营业利润	1,166	8.0%	771	34.8%	95	-	△323	-	1,709	21.5%
营业利润率	36.2	△0.2pt	20.8	△1.9pt	4.1	5.6pt	-	-	19.3	△2.4pt

各公司 (百万日元)	RS		台湾子公司		中国子公司		其他子公司		合并总计	
		前期比		前期比		前期比	合并抵消	前期比		前期比
营业收入	3,590	32.7%	1,420	14.5%	3,637	45.2%	228	-	8,875	37.2%
营业利润	734	43.3%	370	△5.1%	723	21.5%	△118	-	1,709	21.5%
营业利润率	20.4	1.5pt	26.1	△5.4pt	19.9	△3.9pt	-	-	19.3	△2.4pt

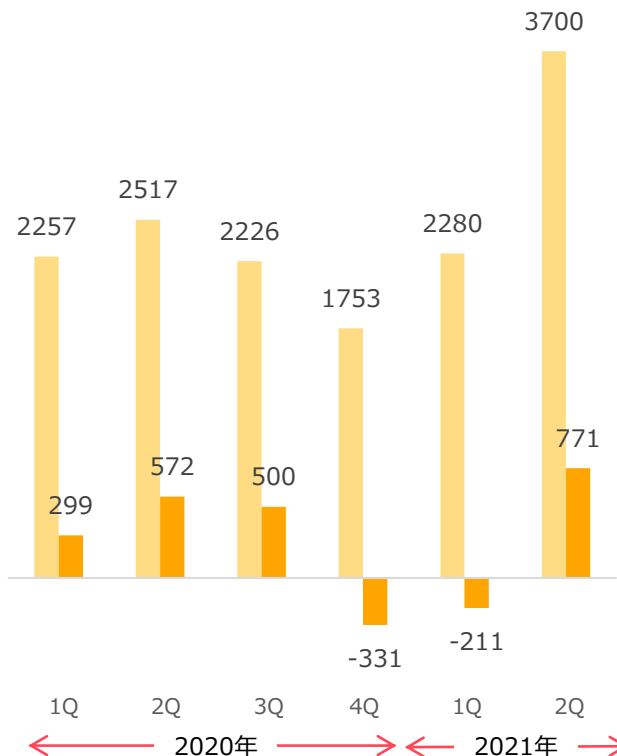
2021年12月期第2季度 各业务季度业绩图

- 在客户需求旺盛的背景下，硅片再生业务继续稳步增长。
- Prime Wafer业务由于新工厂的运转和客户认证的进展，销售额增加，扭亏为盈。
- 半导体相关设备部件业务因强化营业体制因此销售增加，业绩稳步增长。

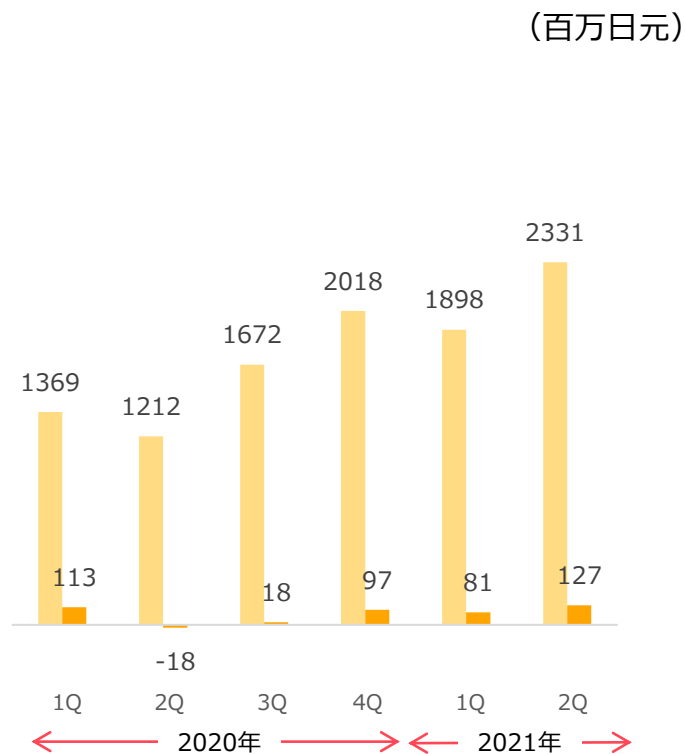
硅片再生业务



Prime Wafer业务

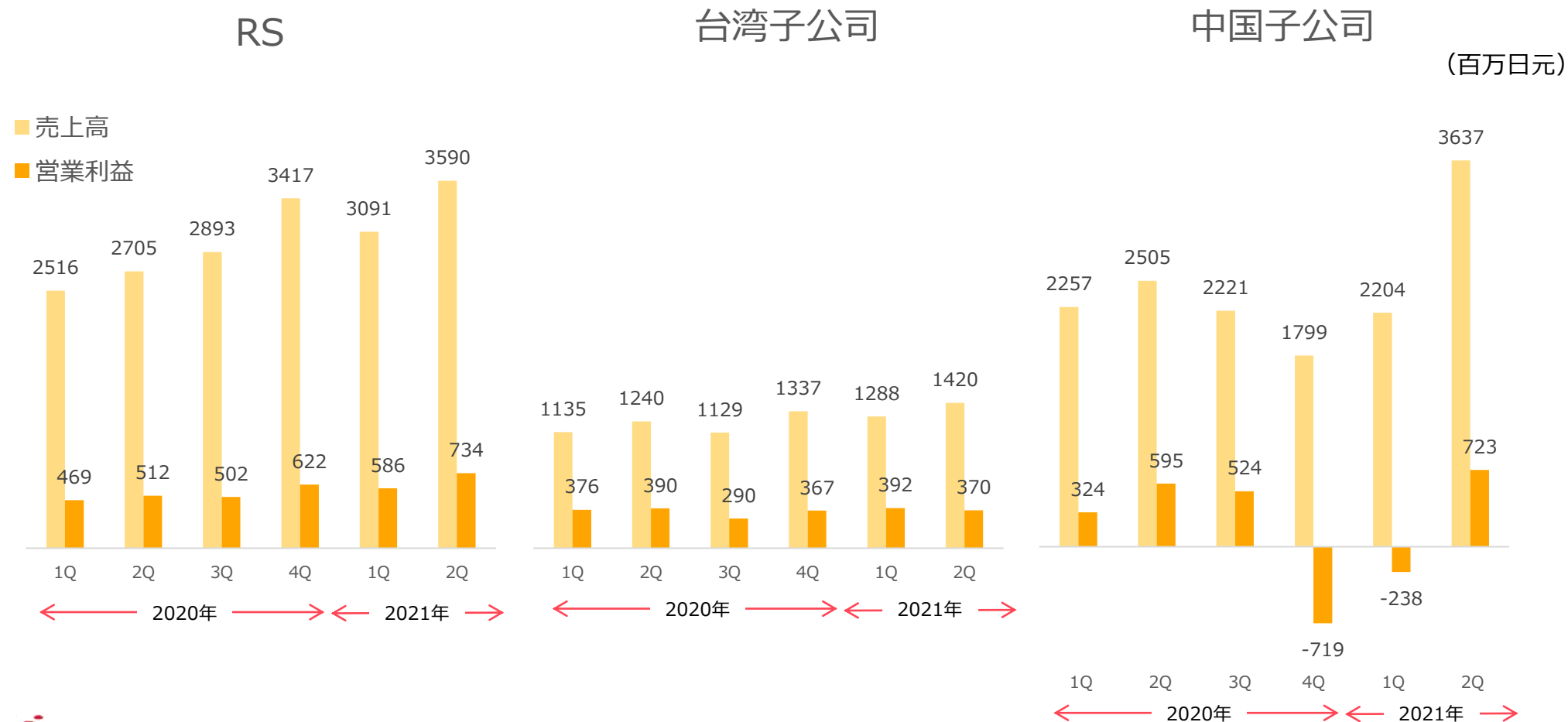


半导体相关设备部件业务



2021年12月期第2季度 各公司动向季度业绩图

- RS因为硅片再生业务增产以及半导体相关设备部件业务的销售增加, 业绩稳步增长.
- 台湾子公司由于在客户需求强劲的背景下通过投资增加产量, 虽然增产导致成本费用有所增加, 但因销售额正在上升, 今后有望得到改善。
- 中国子公司随着客户认证的完成和新工厂开工率的提高, 预计2021年底的销售额和利润都将增长。



资产负债表及现金流量

■ 净资产：74亿日元增加（404亿日元→478亿日元）

■ 经营活动产生的现金流量：+33亿日元

（税前利润：+23亿日元、非现金：+26亿日元、企业所得税支付：▲17亿日元、其他：+1亿日元）

合并资产负债表

（百万日元）	2020年12月期	2021年12月期 第2季度
资产部分		
流动资产	32,626	39,887
货币资金	19,082	24,465
应收票据及应收款	6,321	7,418
商品及产品	2,116	1,765
固定资产	26,124	31,127
有形固定资产	24,146	26,896
无形固定资产	527	506
投资及其他资产	1,451	3,725
资产合计	58,750	71,014
负债部分		
流动负债	12,631	13,559
应付票据及应付账款	2,871	3,149
有息负债	1,522	3,256
固定负债	5,754	9,649
长期借款	1,613	5,369
负债合计	18,385	23,208
净资产	40,365	47,806
负债与净资产合计	58,750	71,014

现金流量表

（百万日元）	2020年 12月期	2021年 12月期 第2季度
经营活动产生的现金流量	6,377	3,287
投资活动产生的现金流量	△9,188	△7,504
筹资活动产生的现金流量	△776	8,725
汇率变动对现金及现金等价物的影响	134	893
现金及现金等价物净增减额	△3,453	5,401
期初现金及现金等价物余额	21,363	17,910
期末现金及现金等价物余额	17,910	23,311

关于记录特别损失（股份支付费用）

■ 背景

- 在2020年11月19日《(披露事项经过)关于本公司海外子公司上市准备的一部分股权转让的通知》中本公司的合并子公司北京有研艾斯半导体科技有限公司(BGRS)所持有的有研半导体材料有限公司(GRITEK)股权将于2021年2月转让给GRITEK员工持股平台。

<本公司的认识>

- GRITEK的企业价值，
要求第三方评估机构（中国证券监督管理委员会指定的专门资产评估机构）进行计算，
并将该机构计算出的公司价值（净资产市场价值）作为公允价值转给员工持股平台。

<审计会计师的认识>

- 机构投资者的报价（报价上限：2021年4月收到）为公允价值。

■ 结果/影响

- 转让价格与审计会计师认识的公允价值之间的差额计入特别损失（1348百万日元）。
- 本案没有现金流出。
- 本案对净资产没有影响。

由于计入特别损失，未分配利润减少，但资本公积增加，因此对净资产没有影响

。

2021年12月期 决算预测

■ 基于2季度累计业绩和3季度以后的预测，上调全年预算。

(百万日元)	2020年12月期	2021年12月期		
	全年	全年		
	实际	最初预测	本次预测	以往的预测比
营业收入	25,561	29,200	31,600	+2,400
营业利润	4,530	5,900	6,100	+200
营业利润率	17.7%	20.2%	19.3%	△0.9pt
经常利润	5,252	5,900	7,300	+1,400
经常利润率	20.5%	20.2%	23.1%	+2.9pt
归属于母公司股东本期净利润	2,824	3,100	3,100	-
每股本期净利润	219.15円	240.51円	240.51円	-
年度分红	20円	20円	20円	-

※ 2021年12月期第2季度最初计划为2021年2月12日，2021年12月期修改后计划为2021年8月4日公布的数值。

3. 中期投资计划

设备投资计划：硅片再生事业

- 随着全球对半导体需求的增长，日本和台湾的产量将扩增，中国山东省将开始大规模批量生产。
- 为应对需求决定增加对台湾的2022年及2023年投资额、2023年将达到月产22万片。

日本

总投资额： 14亿日元

- 扩大12英寸再生硅片的生产能力
- 2021年至2022年：14亿日元（4万片）

12英寸再生硅片生产能力（月产）

2020年	2021年	2022年	2023年
26万片	28万片	30万片	30万片

2021年度	2022年度	2023年度
9亿日元	5亿日元	未定

台湾

总投资额： 25亿日元

- 扩大生产能力并实现12英寸再生硅片的小型化
- 2021-2023年：25亿日元（6万片）

12英寸再生硅片生产能力（月产）

2020年	2021年	2022年	2023年
16万片	18万片	19万片	22万片

2021年度	2022年度	2023年度
8亿日元	7亿日元	10亿日元

中国

总投资额： 36亿日元

- 投资建立新的12英寸再生硅片生产基
- 一期投资（2021-2023年）：36亿日元（5万片）
- 第二阶段投资（从2024年开始）：投资额未定（5万片）

12英寸再生硅片生产能力（月产）

2020年	2021年	2022年	2023年
0万片	0万片	5万片	5万片

第1期投資

2021年度	2022年度	2023年度
30亿日元	5亿日元	1亿日元

设备投资计划：PRIME WAFER事业

- 8英寸PRIME WAFER将尽早启动新厂，以构筑月产能13万片的量产体制为目标。
- 12英寸PRIME WAFER设置月产1万片的测试线，推进量产化研究开发。

中国 8寸

- 新工厂的早期启动
- 以构筑稳定的量产体制为目标

8英寸的PRIME WAFER生产能力（月产）

2020年
8万片 → 2021年
13万片

2021年度	2022年度	2023年度
-※1	未定	未定

※1 到2020年度为止已投资完毕

中国 12寸

测试线投资额： 40亿日元

- 12英寸的PRIME WAFER量产化的研究开发经过1万张的测试线
- 以30万片的量产体制为目标

12英寸的PRIME WAFER生产能力（月产）

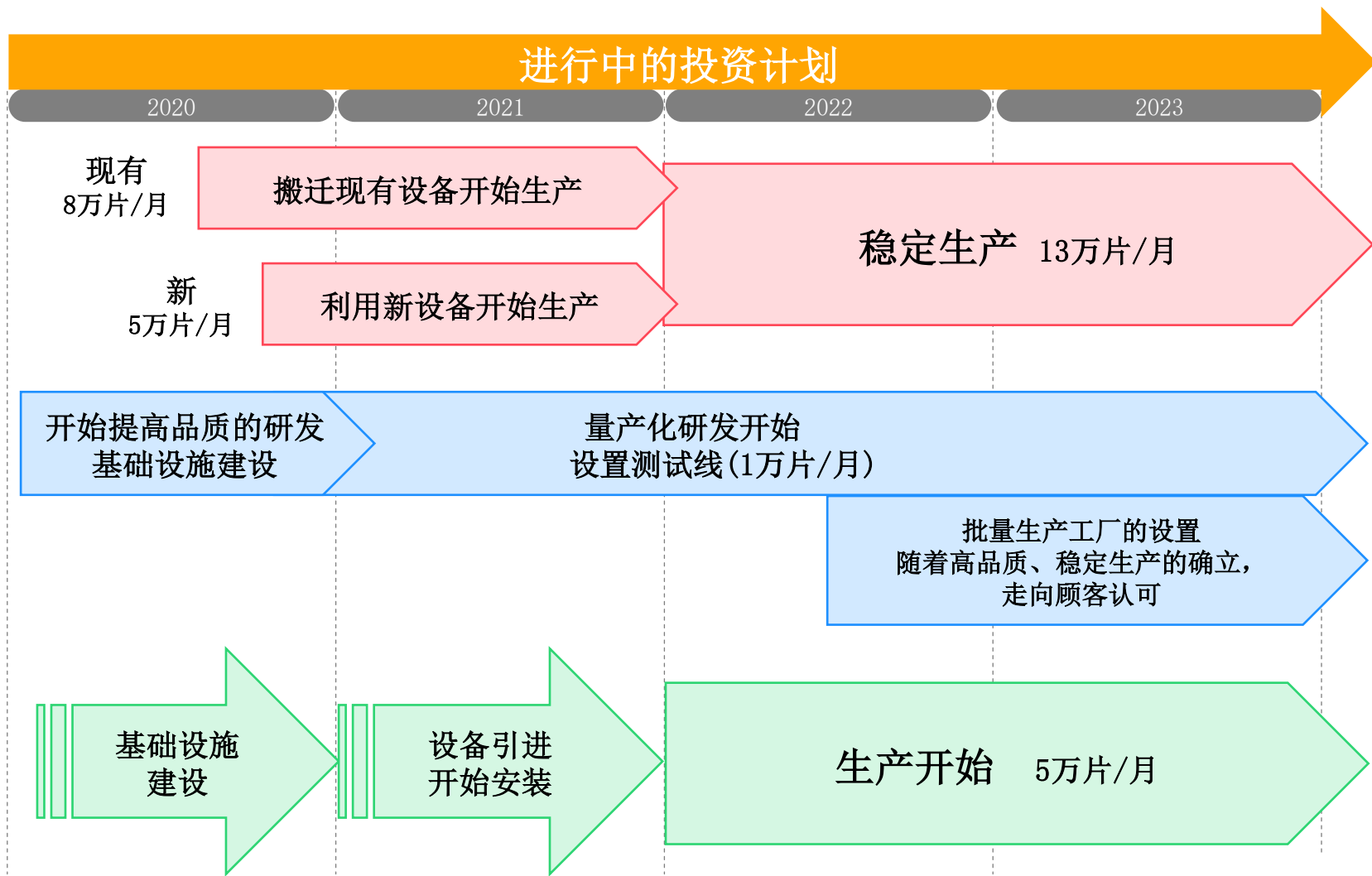
2020年
0万片 → 2021年
1万片※2 → 202X年
30万片

2021年度	2022年度	2023年度
40亿日元	未定	未定

※2 量产化研究开发的测试线

中国投资计划（时间表）

- 同时完成8英寸月产能13万片的稳定生产，12英寸月产能1万片的量产研究开发，硅片再生事业的启动。以尽早达到12英寸高品质，稳定生产为目标。



硅片再生事业的新需求：12英寸半导体新工厂

- 为了满足中、欧、日等国家因存储器、CPU、汽车电子化等而产生对半导体强劲的需求，12寸半导体新工厂正在建设中。
- 通过对日本、台湾及中国的设备投资，对应新的再生片需求。

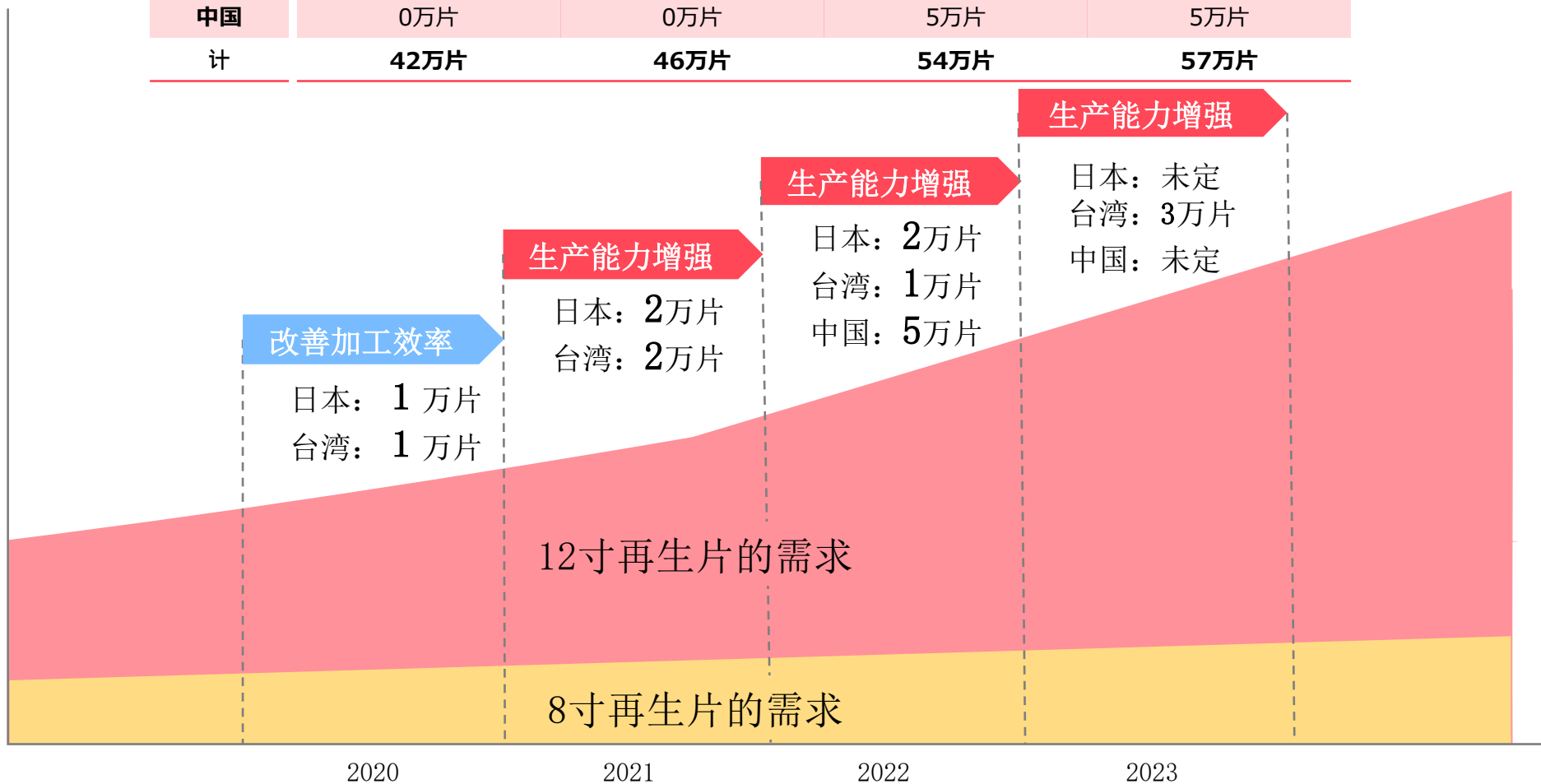


注：RST调查

再生硅片的需求前景：以12英寸为中心持续扩大

■ 为满足不断扩大的再生硅片需求，预计2021~2023年分别实现日本4万片、台湾6万片、中国5万片的产能提高。

生产能力	2020年末	2021年末	2022年末	2023年末
日本	26万片	28万片	30万片	30万片
台湾	16万片	18万片	19万片	22万片
中国	0万片	0万片	5万片	5万片
计	42万片	46万片	54万片	57万片



注：RST调查数据

第3成长引擎：DG Technologies成长战略（1/3）

- DG Technologies是为大型半导体制造商及半导体设备制造商提供消耗零件的零件制造商。
- 2019年1月成为本公司的子公司。

公司概况

DGtec 株式会社DGテクノロジーズ

公 司 名	株式会社DG Technologies
成 立	1981年10月26日
事 业 内 容	制造并销售半导体制造装置用的消耗零件
所 在 地	茨城县神栖市砂山3-4
资 本 金	100,000千日元
法定 代表 人	方 永义

产品

干蚀刻设备用
石英·硅制消耗零件



硅电极



石英环

主要顾客

半导体制造商
半导体设备制造商等

第3成长引擎：DG Technologies成长战略（2/3）

- 干蚀刻设备用零件市场预计为1500亿日元*1，预计今后会增长。
- 决策并执行生产能力扩大与生产效率化相关的成长战略以及由RS既存硅片顾客的销售与GRITEK的采购产生的协同作用。目标是占据该市场第一。

市场的成长性

干蚀刻设备用
石英·硅制消耗零件



约1,500亿日
元 *1

期待和干蚀刻设备市场同
程度的成长

(先行指标)

干蚀刻设备市场



成长率
8% *2

成长战略

- ◆ 经营活动的强化
对RS既存硅片顾客进行交叉销售
- ◆ 生产能力的增强
进行设备投资，构建体制及时生产供货满足顾客的要求
- ◆ 提高生产效率
增强生产能力，实现人员及生产工程的最优化，提高生产效率
- ◆ 采购最优化
从本集团的公司GRITEK采购原材料，强化竞争力

第3成长引擎：DG Technologies成长战略（3/3）

- 因神栖工厂完全运作，为应对增长的顾客需求，2021年5月设立了宫城县栗原工厂。
- 由以前的生产据点神栖工厂与栗原工厂（新设）2个据点对增加的订单。

神栖工厂



工厂名	DG Technologies 神栖工厂
所在地	茨城县神栖市
建筑面积	5,378m ²

栗原工厂



硅电极

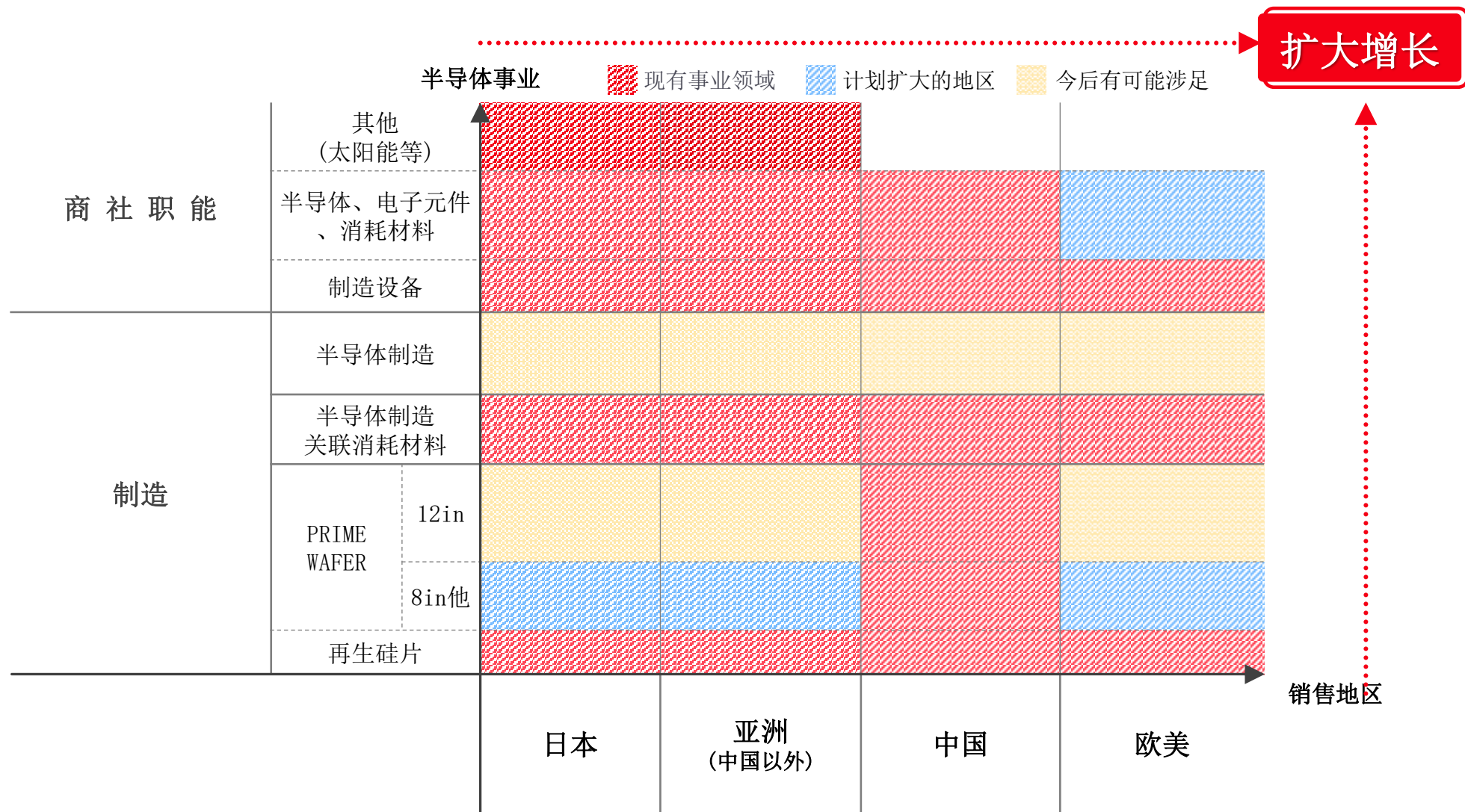


石英环

工厂名	DG Technologies 栗原工厂
所在地	宫城县栗原市
建筑面积	5,000m ²

RS Technologies追求的世界

■ 一步一步，逐步扩大事业领域和销售地区。



Appendix 1

中国子公司GRITEK上市准备：目前的进展

中国子公司（GRITEK）上市准备（2020年9月开示）

- 2020年9月中国子公司（GRITEK）开始准备上市。
- 通过上市，确立事业基盘，确保成长性，增加本集团的企业价值。

上市的目的

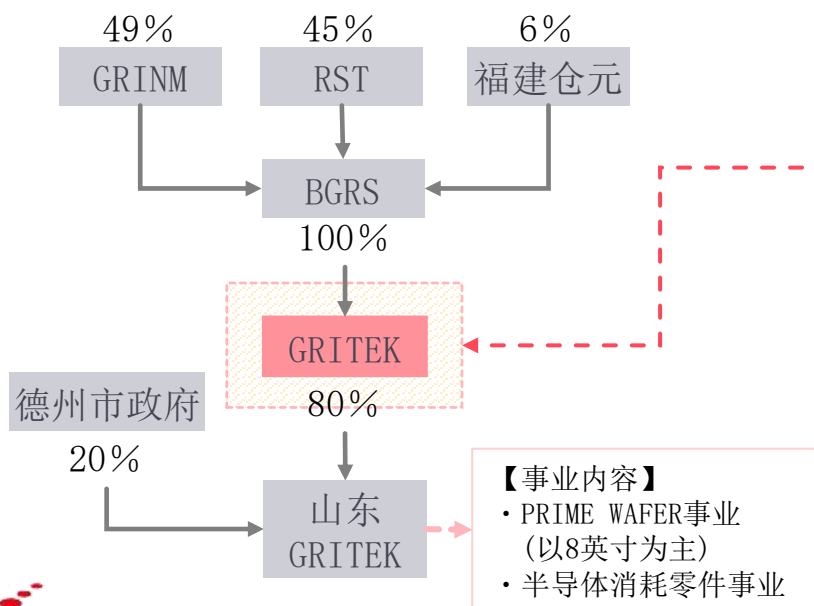
确立在中国的事业基盘

- 筹资手段的多样化
- 知名度提高
- 吸引优秀的人才

确保成长性

- 确保成长资金
- 强化营业能力
- 促进研发并提高生产性

增加本集团的企业价值



上市主体：GRITEK

- 1999年成立，从事PRIME WAFER的制造与销售
- 2018年成为本公司的子公司
- 2020年工厂迁移，山东GRITEK成为PRIME WAFER的生产据点

预定上市市场：科创板市场（STAR Market）

- 被称为中国版纳斯达克的上海证券交易所面向新兴企业的股票市场
- 在中国政府的倡议下开设，于2019年7月22日开始交易
- 与其他市场相比，放宽了诸如盈利能力之类的上市标准，简化了审查程序
- 股票以新兴的高科技公司为主
- 最初有25只股票上市，在一年内扩展到130多家公司

中国子公司（GRITEK）上市准备的进展（2020年11月开示）

- 2020年11月19日召开的董事会决议，作为中国子公司（GRITEK）上市准备的一环，将转让BGRS所有的一部分GRITEK股份。

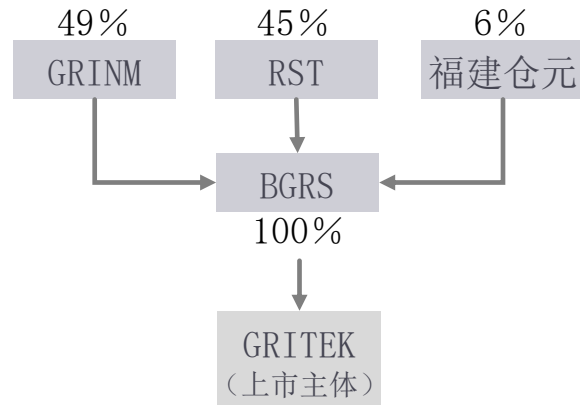
股份转让概要

- 转让前：BGRS持有GRITEK100%的股份。
- 转让内容：BGRS将持有的GRITEK股份分别转让25.60%给GRINM、3.14%给福建仓元、5.00%给员工持股、23.51%给本公司。

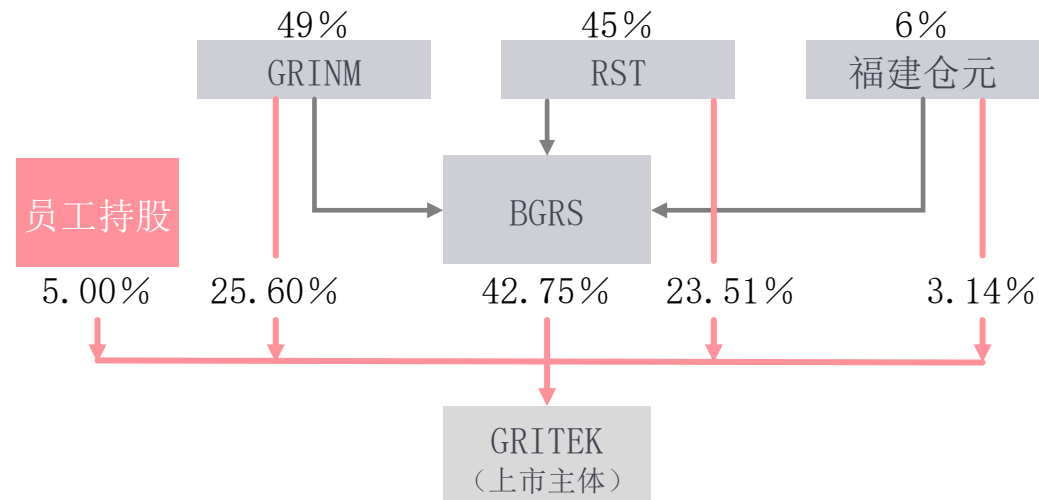
股份转让目的

- 提高员工的积极性与归属感
 - 维持与中国国有机关GRINM之间良好关系
- ↓
- 提高本集团的企业价值

股份转让前



股份转让后



Appendix2

董事长 方永义的优势

- 董事长总经理方永义的优势是充分发挥20多年来在日本积累的见识和自己拥有的人脉，面向全球的营销能力、人际关系、合作能力及资金实力。
- 方永义麾下集结了高科技、金融等广泛领域的专业人财。



前排中央为方永义（2016年9月摄于东京证券交易所）

方 永义

1970年出生 中国福建省人

城西国际大学研究生院 结业

擅长领域：

并购、业务合作（过去成功并购了超过10家企业）

1998年 成立永辉商事

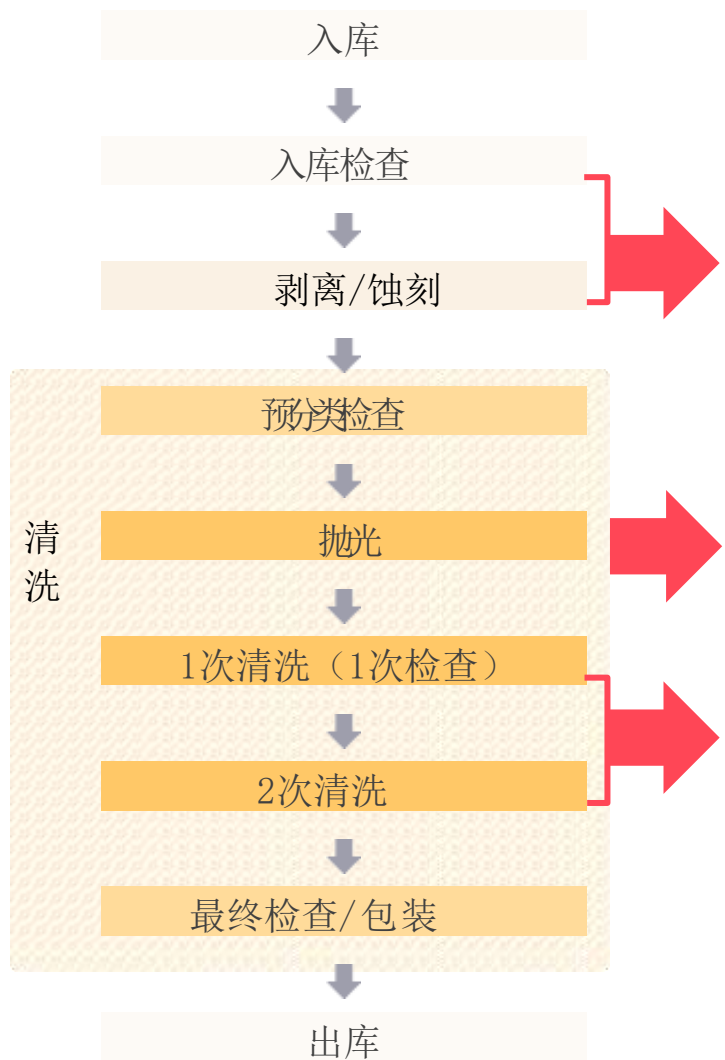
2010年 成立本公司并就任总经理（
现任）

座右铭：事在人为

补充：

高中毕业后来日。拥有日本国内外的20多家公司的投资经验。除半导体业务外，还有基金、贸易、酒店、IT业务、农业等各种行业的投资经验。以“日本的制造服务世界第一”为信条，奔走于世界各地，向全球推广日本的制造服务。

硅片再生业务(1)



强项 1

所有膜均可剥离

· 因通过化学方式进行剥离, 对表面的损伤最小

▶ 再生次数多

▶ 可降低成本

继承了拉萨工业(化学)的特技



通过抛光去除表面杂质使其平滑

强项 2

金属不纯物的去除

通过洗净除去硅片表面的细微杂质

+ 金属不纯物的去除, 尤其擅长铜 (Cu) 的除色除杂质

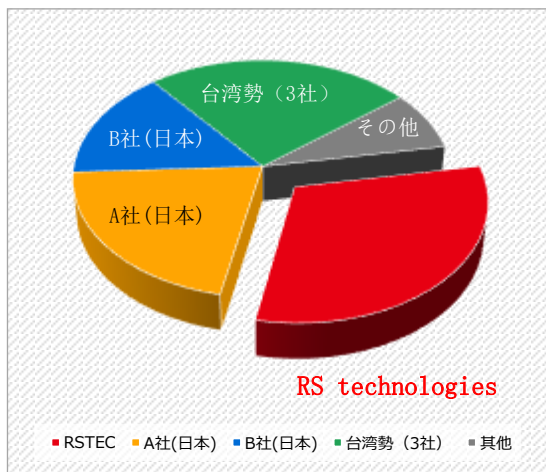


杂质(颗粒) 金属不纯物

硅片再生业务(2)

扩大本公司在再生市场占有的份额

本公司在12英寸硅片市场上所占的份额



注：RST调查

由于增设了台湾工厂和三本木工厂，生产能力提高了，目前的市场份额已上升到约33%。

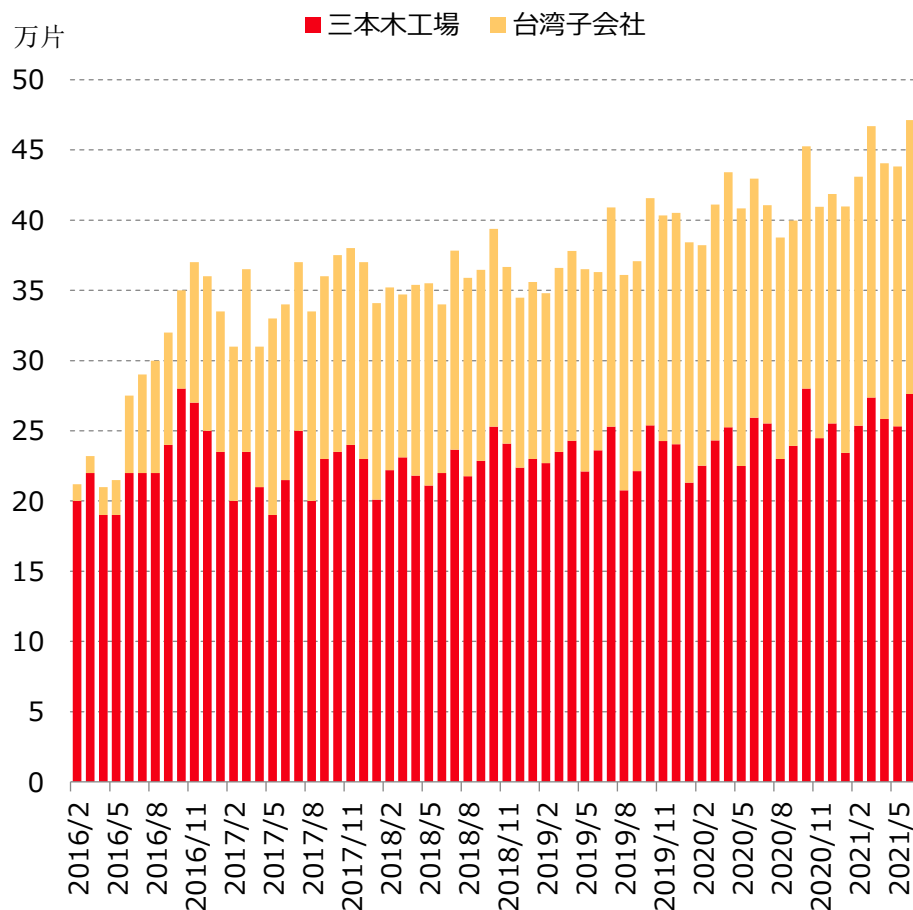
旨在通过利用两家工厂的现有设施提高生产力，利用三本木的空工厂，业务合作和并购等方式进一步扩大市场占有率。

	2015年 上期	2015年 下期	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
本集团生产能力	18万片	24万片	28万片	30万片	34万片	40万片	42万片
本集团所占市场份额	19%	24%	29%	30%	31%	33%	33%

注：RST调查

三本木工厂和台湾子公司的出货量 (2016年-2021年)

三本木工厂和台湾子公司的12英寸硅片出货量



硅片再生事业制造据点

- 三本木工厂和台南工厂两家工厂在运营，应对世界各地的客户。
- 2022年，中国德州工厂（月产5万片起步）投产，预计构建三据点体系。

三本木工厂



台南工厂



德州工厂



所在地	宫城县大崎市
负责尺寸	5英寸、6英寸、8英寸、12英寸
生产能力	8英寸：月产13万片 12英寸：月产26万片
认证	ISO9001, ISO14001

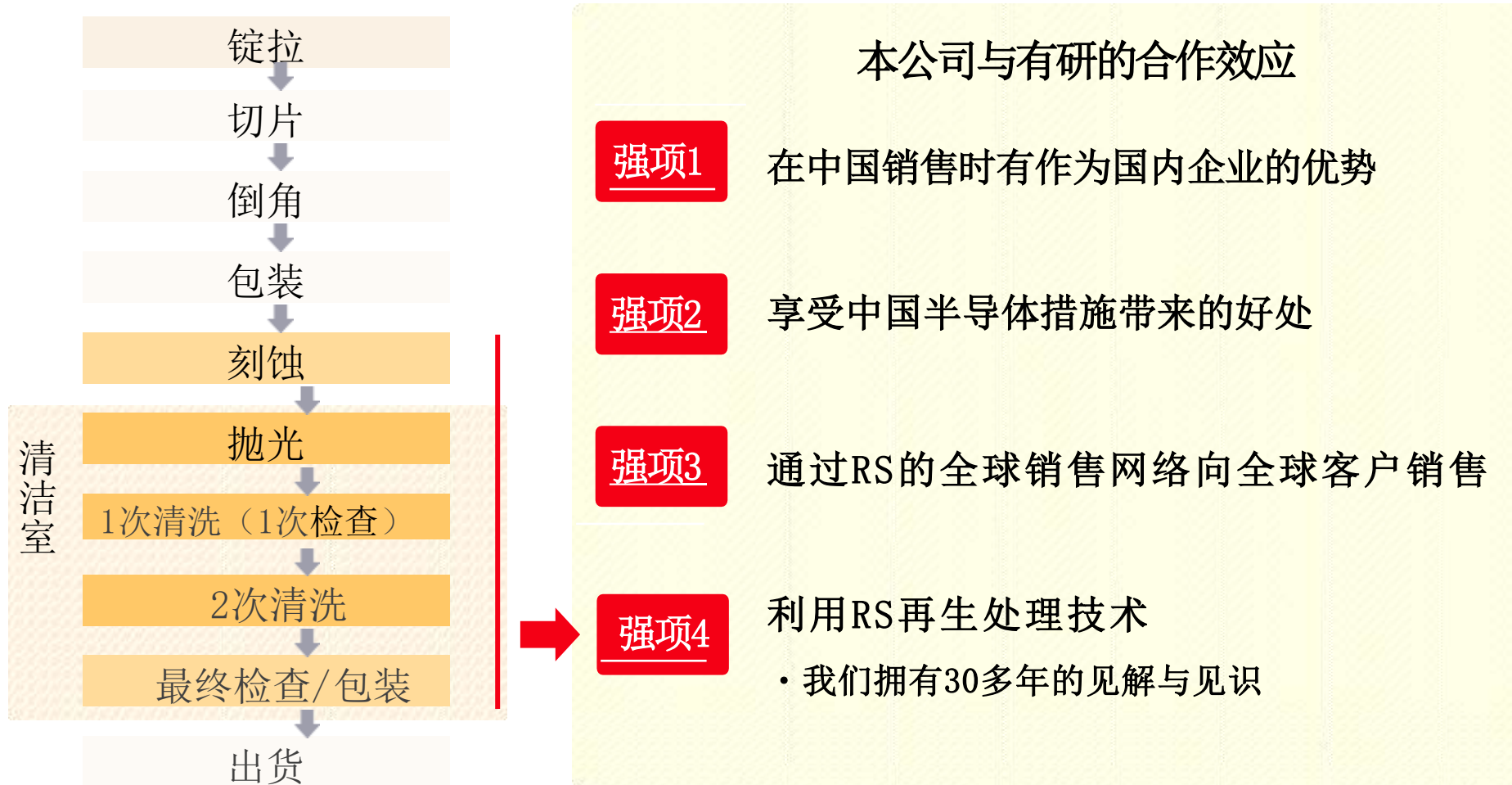
所在地	台湾台南市
负责尺寸	12英寸
生产能力	12英寸：月产16万片
认证	ISO9001, ISO14001

所在地	中国山东省德州市
负责尺寸	12英寸
生产能力	12英寸：月产5万片※
认证	ISO9001, ISO14001

※2022年に生産開始予定

进军PRIME WAFER行业

与中央政府直属企业北京有色金属研究总院（现为有研科技集团有限公司）成立合资公司。
作为国内内资企业（中国国内公司）发展半导体业务



关于我们在中国的合资伙伴

- 成立于1952年。中国有色金属领域最大的国有研究所。
- 在中国大约1300万家公司中，国有企业有30万家。其中，中央政府直属企业有88家，GRINM是其中之一。
- 这是一个集政府，产业和学术界于一体的研究机构，中央政府在有色金属领域的政策是通过该公司宣布的。
- 为发扬研究成果，成立事业公司。目前，有34家公司。
- 本公司的合资子公司GRITEK是在北京有研艾斯半导体科技有限公司（BGRS）伞下成立于2001年的第一家事业公司。



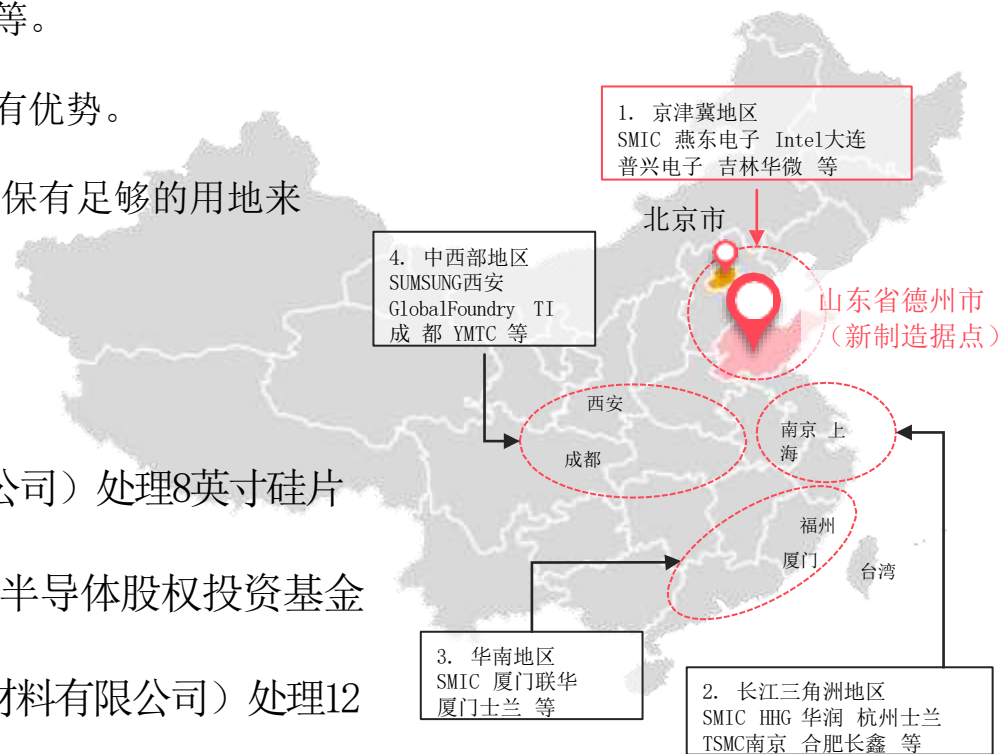
与山东省德州市的合作：背景、经过及现状（山东有研新工厂竣工）

合作背景

1. 世界主要半导体制造商被吸引到周边地区建工厂，是靠近半导体制造商聚集地的良好位置（请参照右图）
2. 福利待遇优厚，例如减免水电费及提供廉价的公司宿舍等。
3. 附近有一所理工系大学，在获得优秀的人力资源方面具有优势。
4. 该基地最大可扩展至约50万m²（最初为20万m²），可确保有足够的用地来应对未来在中国的业务推进。

经过和现状

1. 2018年8月成立新公司（山东有研半导体材料有限公司）处理8英寸硅片业务。
2. 2019年12月与有研科技集团有限公司、德州汇达半导体股权投资基金合伙企业及山东省德州市政府签订四方合资合同。
3. 2020年3月成立新合资公司（山东有研艾斯半导体材料有限公司）处理12英寸硅片业务。
4. 2020年10月举行德州市新工厂竣工仪式。



PRIME WAFER的制造事业及研究开发据点

- 2020年10月，作为8英寸硅片的制造基地，德州工厂建成并开始运营。
- 在中国北京的国泰工厂建立了12英寸PRIME WAFER量产化的研发基地。2021年建成月产1万片的测试线，同步发展量产技术并提升品质。

8英寸PRIME WAFER制造据点
德州工厂（山东GRITEK）



所在地	中国山东省德州市
制品	5, 6, 8英寸PRIME WAFER 半导体装置消耗部件
生产能力 (月产)	5英寸:5万片、6英寸:15万片 8英寸:13万片※
认证	ISO9001, ISO14001

12英寸PRIME WAFER研究开发据点
国泰工厂 研究开发中心（SGRS）

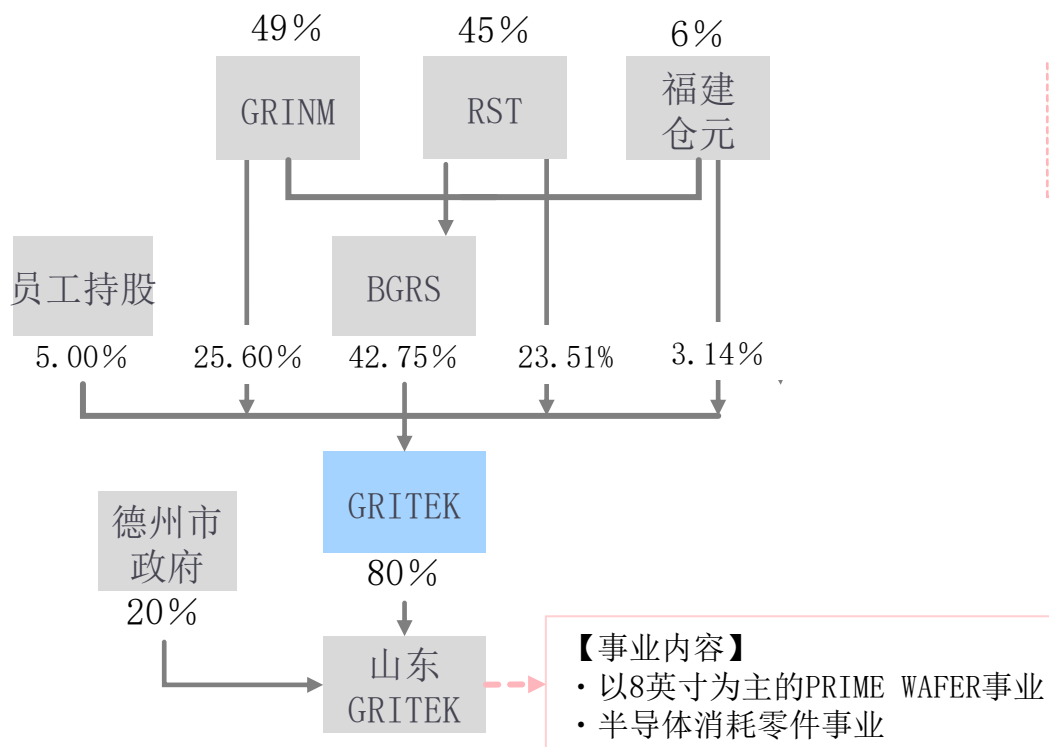


所在地	中国北京市
业务内容	12英寸PRIME WAFER 量产化研究开发
生产能力 (月产)	12英寸:1万片（测试线）

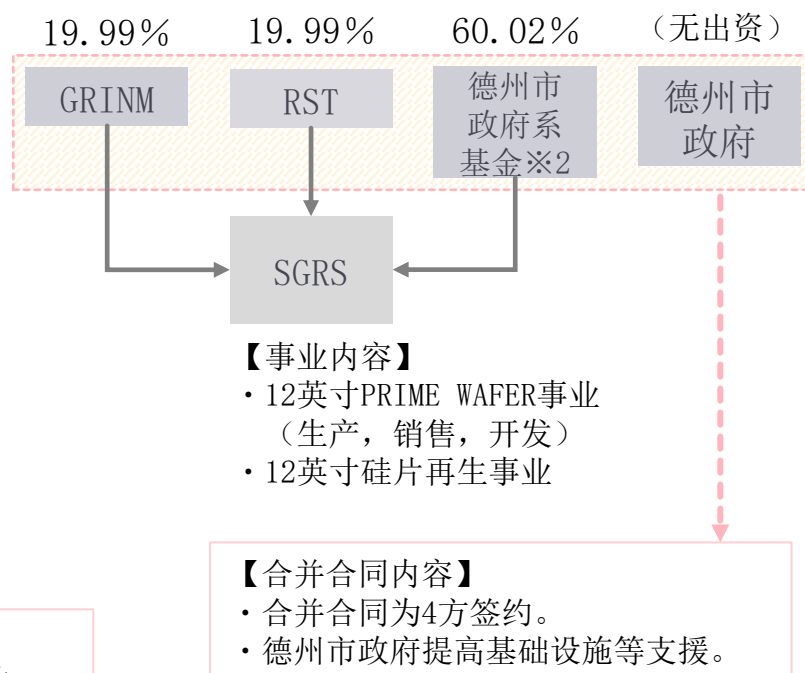
对中国事业的出资方案（2021年5月开示内容实施后）

- 作为上市准备的一环，董事会决议实施部分股权转让，转让BGRS持有的部分GRITEK股份（2020年11月公开），转让GRITEK第三方发行的新股及本公司权益控股公司（SGRS）的股份（2021年5月开示）。
- 上述开示内容实施后的出资形态如下。

8英寸硅片事业 出资形态※1



12英寸硅片事业 出资形态



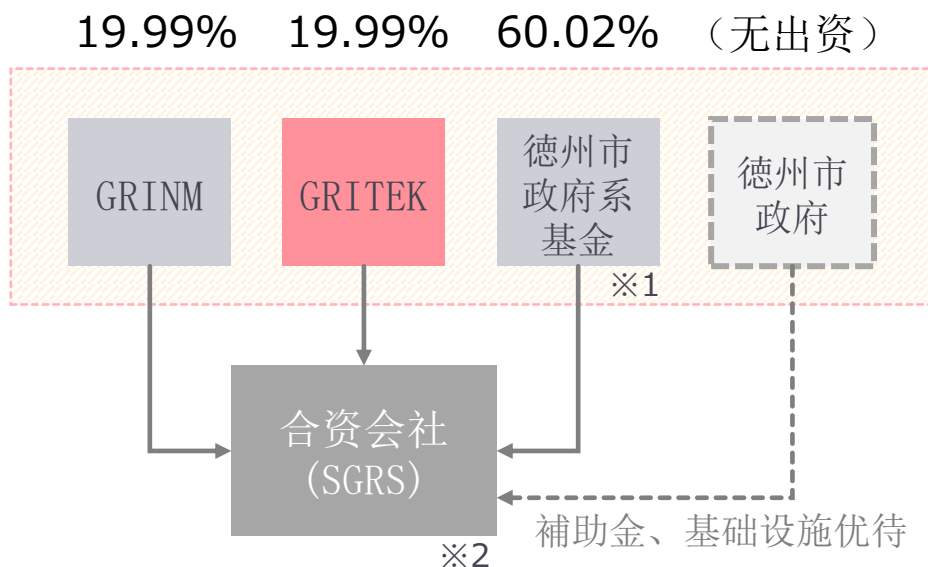
※1 2020年11月19日的开示资料「（开示事项经过）与本公司海外子公司上市准备相关的部分股权转让的通知」的开示内容实施后的出资形态。对SGRS的出资比率为最终出资比率，对其出资根据出资合同分阶段实施。

※2 德州汇达半导体股权投资基金合伙企业

中国12英寸PRIME WAFER事业（2021年5月开示内容实施后）

- 2021年5月，董事会决议将本公司持有的SGRS股份转让（换股）给GRITEK。
- 由于此次转让，SGRS 将成为我们合并子公司 GRITEK 的控股公司（转变为通过 GRITEK 间接控股）。
- 通过GRITEK从事12英寸PRIME WAFER业务将有助于实现PRIME WAFER业务战略。

SGRS股份转让后的投资方案



本次转让中的方案变更点

- ◇ SGRS成为 GRITEK 的权益法控股公司
 - 实现中国硅业务一体化管理
 - 被认定为实现优秀硅产业战略做出贡献
- ◇ 本公司方董事长将继续兼任SGRS董事长。
 - 通过我们的子公司 GRITEK 继续控制
- ◇ 本公司的权利和义务由 GRITEK 全面继承
 - 通过 GRITEK，可以行使之前拥有的权利

※1 德州汇达半导体股权投资基金合伙企业

※2 山东有研RS半导体材料有限公司

业绩变化

(百万日元)	2013年 12月期	2014年 12月期	2015年 12月期	2016年 12月期	2017年 12月期	2018年 12月期	2019年 12月期	2020年 12月期
营业收入	3,475	4,566	5,285	8,864	10,932	25,478	24,501	25,561
毛利润	1,173	1,820	1,852	2,544	4,252	8,366	7,940	8,681
营业费用	471	654	791	958	1,269	2,615	3,223	4,151
营业利润	703	1,166	1,061	1,585	2,982	5,751	4,717	4,530
经常利润	819	1,247	770	1,444	3,159	6,141	5,416	5,252
当期净利润 ※	525	664	143	861	2,113	3,620	3,035	2,824
分红 (日元)	—	—	—	10	5	10	15	20
设备投资	338	3,503	4,665	209	95	1,328	4,809	12,409
折旧	87	103	326	682	714	1,298	1,814	1,674
研究开发费	1	6	11	85	183	501	449	929
员工人数 (正式员工) (人数)	152	191	265	373	434	1,159	1,277	1,187

※归属于母公司的当期纯利润

主要财务报表

(百万日元)	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
资产部分								
流动资产	1,811	2,759	3,732	5,348	7,388	26,074	32,760	32,626
货币资金	397	1,190	1,842	1,952	3,243	14,879	22,156	19,082
应收票据及应收账款	681	696	795	2,531	2,916	6,958	6,047	6,321
商品及产品	396	376	361	348	446	1,343	1,713	2,116
固定资产	508	4,064	5,845	5,333	4,843	10,516	15,873	26,124
有形固定资产	461	3,918	5,667	5,152	4,674	8,963	14,635	24,146
无形固定资产	19	15	29	23	19	1,099	732	527
投资及其他资产	27	130	148	158	149	453	506	1,451
资产合计	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750
负债部分								
流动负债	960	2,292	2,295	2,993	3,370	4,979	7,252	12,631
应付票据及应付账款	138	151	186	283	398	1,554	1,614	2,871
有息负债	136	827	1,216	1,538	1,276	976	1,730	1,522
固定负债	709	2,934	4,798	4,317	3,335	2,474	5,400	5,754
长期借款	615	2,925	4,079	3,620	2,767	1,848	2,232	1,613
负债合计	1,670	5,227	7,093	7,310	6,705	7,453	12,652	18,385
净资产部分								
净资产	649	1,596	2,483	3,371	5,526	29,137	35,981	40,365
负债与净资产合计	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750

*截至2013年12月的财政年度的非合并财务业绩

各事业业绩变化

(百万日元)	2013年 12月期	2014年 12月期	2015年 12月期	2016年 12月期	2017年 12月期	2018年 12月期	2019年 12月期	2020年 12月期
营业收入								
硅片再生事业	3,347	4,414	5,107	7,144	9,487	10,973	10,776	11,461
PRIME WAFER制造销售事业	—	—	—	—	—	11,918	10,058	8,755
半导体生产设备的买卖事业	—	—	—	1,654	1,393	2,918	4,047	6,272
其他, 调整金额	127	151	178	66	52	△331	△380	△927
各事业利润								
硅片再生事业	916	1,444	1,377	1,765	3,396	4,011	4,081	4,027
PRIME WAFER制造销售事业	—	—	—	—	—	2,048	1,503	1,041
半导体生产设备的买卖事业	—	—	—	230	130	366	171	211
其他, 调整金额	△214	△278	△316	△409	△543	△675	△1,038	△749
各事业资产								
硅片再生事业	1,337	5,040	6,987	5,657	8,120	9,150	10,336	11,698
PRIME WAFER制造销售事业	—	—	—	—	—	21,313	29,311	35,697
半导体生产设备的买卖事业	—	—	—	1,137	1,305	1,939	3,179	5,387
其他, 调整金额	982	1,783	2,589	3,887	2,805	4,315	5,806	5,968

2015年、2016年、2017年12月期的决算数值是2019年3月5日公布的修正后的数值。

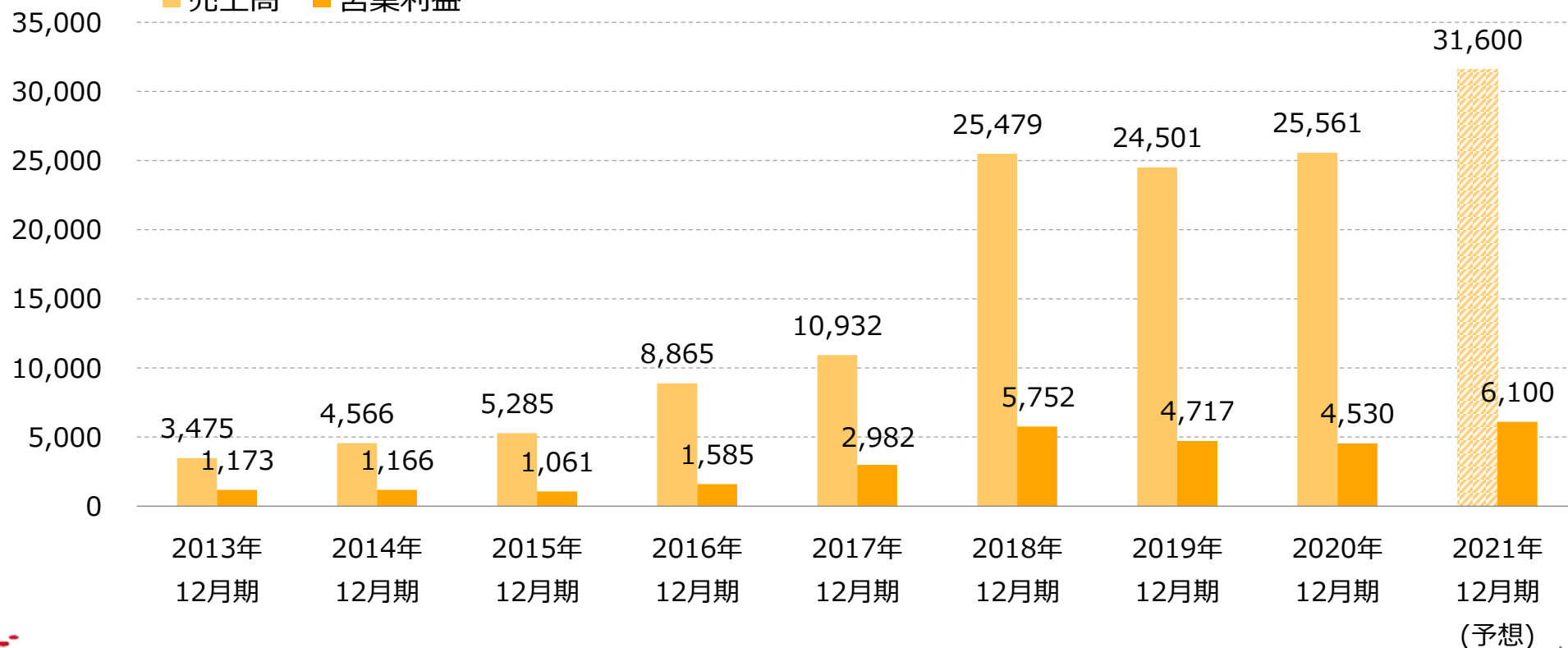
连结业绩推移

- 2014年2月，在台湾成立艾爾斯半導體股份有限公司（RSTW）。2015年12月，台南工厂竣工。
- 2015年6月，配备最先进设备（可再生18英寸硅片）的三本木工厂和第8工厂竣工。
- 2018年1月，中国主要硅片制造商有研半导体材料有限公司（GRITEK）成为合并子公司。
- 2020年10月，中国山东省德州工厂建成并作为PRIME WAFER制造基地投入运营。

合并销售和营业收入

(百万日元)

■ 売上高 ■ 営業利益



※2021年12月期(予想)是根据2021年8月4日公开的数据制作。

本资料中记载的内容，是在一般认为的经济形势和本公司认为合理的一定前提下制作的，若因外部经营环境的变化而更改，恕不提前通知。

在本次发布时获得的资料和信息当中，包括“预测信息”。这些信息是根据现在的估计、预测以及带有风险的假设得出的，含有不确定性，也许与实际结果相左。

即使今后出现新的信息、事情等，本公司也不承担更新和修正本次发布所含的“预测信息”的义务。